



平成19年 3月26日

各 位

会 社 名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代 表 者 執行役社長 林 將章
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号
コード番号 8036 (東証・大証第一部)
問い合わせ先 社長室 広報・IRグループ 部長代理
加藤弘之 (電話: 03-3504-5138)

子会社の合併に関するお知らせ

当社は本日開催の執行役常務会において、100%子会社である日立ハイテクデーイーテクノロジー株式会社(以下、日立ハイテクデーイーテクノロジー)と株式会社日立ハイテクインスツルメンツサービス(以下、日立ハイテクインスツルメンツサービス)が合併することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

日立ハイテクデーイーテクノロジーは、液晶パネル製造検査装置・磁気ディスク製造検査装置等の保守サービス、及び半導体製造ラインの支援業務を主力事業としています。また、日立ハイテクインスツルメンツサービスは、電子部品実装装置の保守サービスを主力事業としています。

今回、平成19年6月1日付けで両社を発展的に統合し、株式会社日立ハイテクエンジニアリングサービス(仮称)を発足します。この統合により、双方の持つ経営ノウハウやインフラを活用し、連結経営の効率化とグローバルなCS(顧客満足)の向上を目指していきます。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程(予定) :

合併契約書承認執行役常務会	平成19年3月26日
合併承認株主総会	平成19年3月28日(日立ハイテクデーイーテクノロジー) 平成19年3月29日(日立ハイテクインスツルメンツサービス)
合併契約書締結	平成19年3月29日
合併の予定日(効力発生日)	平成19年6月1日

(2) 合併方式: 日立ハイテクデーイーテクノロジーを存続会社とする吸収合併方式とし、日立ハイテクインスツルメンツサービスは解散します。

3. 合併当事会社の概要

(平成18年9月30日現在)

(1) 商号	日立ハイテクデーイーテクノロジー株式会社	株式会社日立ハイテクインスツルメンツサービス
(2) 事業内容	液晶パネル製造検査装置・磁気ディスク製造検査装置等の保守サービス、及び半導体製造ラインの支援業務	電子部品実装装置の保守サービス
(3) 設立年月日	昭和56年9月19日	昭和63年11月9日
(4) 本店所在地	神奈川県足柄上郡中井町久所300	群馬県邑楽郡大泉町仙石2-26-1
(5) 代表者の役職・氏名	取締役社長 田島 孝一	取締役社長 茂木 文雄
(6) 資本金	3億20百万円	50百万円
(7) 発行済株式数	640,000株	1,000株
(8) 純資産	12億7百万円	8億88百万円
(9) 総資産	56億53百万円	12億67百万円
(10) 決算期	3月末日	3月末日
(11) 従業員数	580名	100名
(12) 大株主及び持株比率	(株)日立ハイテクノロジーズ (100%)	(株)日立ハイテクノロジーズ (100%)

4. 合併後の状況

(1) 商号	株式会社日立ハイテクエンジニアリングサービス(仮称)
(2) 事業内容	液晶パネル製造検査装置・磁気ディスク製造検査装置・電子部品実装装置等の保守サービス、および半導体製造ラインの支援業務
(3) 設立年月日	平成19年6月1日
(4) 本店所在地	東京都港区西新橋1-24-14
(5) 代表者の役職・氏名	取締役社長 茂木 文雄
(6) 資本金	3億70百万円
(7) 総資産	62億円
(8) 決算期	3月末日
(9) 従業員数	590名
(10) 大株主及び持株比率	(株)日立ハイテクノロジーズ(100%)

5. 今後の見通し

合併による当社業績に与える影響は軽微です。

以上